

INTERNATIONAL STANDARD

NORME INTERNATIONALE



Semiconductor devices – Semiconductor devices for energy harvesting and generation –

Part 1: Vibration based piezoelectric energy harvesting

Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs à semiconducteurs pour récupération et production d'énergie –

Partie 1: Récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations

INTERNATIONAL
ELECTROTECHNICAL
COMMISSION

COMMISSION
ELECTROTECHNIQUE
INTERNATIONALE

ICS 31.080.99

ISBN 978-2-8322-0000-0

**Warning! Make sure that you obtained this publication from an authorized distributor.
Attention! Veuillez vous assurer que vous avez obtenu cette publication via un distributeur agréé.**

CONTENTS

FOREWORD.....	4
1 Scope.....	6
2 Normative references	6
3 Terms and definitions	6
3.1 General terms.....	6
3.2 Piezoelectric transducer.....	8
3.3 Characteristic parameters	9
4 Essential ratings and characteristic parameters	11
4.1 Identification and type.....	11
4.2 Limiting values and operating conditions	11
4.3 Additional information	11
5 Test method	12
5.1 General.....	12
5.2 Electrical characteristics	13
5.2.1 Test procedure	13
5.2.2 Capacitance	14
5.2.3 Resonant frequency.....	14
5.2.4 Bandwidth.....	15
5.2.5 Open circuit voltage.....	15
5.2.6 Output voltage.....	15
5.2.7 Output current	16
5.2.8 Output power.....	16
5.2.9 Optimal load impedance	17
5.2.10 Maximum output power.....	17
5.2.11 Settling time	17
5.3 Mechanical characteristics	18
5.3.1 Test procedure	18
5.3.2 Temperature range	19
5.3.3 Relative humidity range	19
5.3.4 Input vibration.....	20
Annex A (informative) Piezoelectric mode.....	21
A.1 d_{33} mode.....	21
A.2 d_{31} mode.....	21
Bibliography.....	22
Figure 1 – A vibration based energy harvester using cantilever with piezoelectric film	7
Figure 2 – Conceptual diagram of a vibration based piezoelectric energy harvester	8
Figure 3 – Equivalent circuit of a vibration based piezoelectric energy harvester	10
Figure 4 – Measurement procedure of vibration based piezoelectric energy harvesters	13
Figure 5 – Test setup for the electrical characteristics of a vibration based piezoelectric energy harvester.....	14
Figure 6 – Frequency response of a vibration based piezoelectric energy harvester	15
Figure 7 – Output voltage of a vibration based piezoelectric energy harvester at various external loads	16
Figure 8 – Output current of a vibration based piezoelectric energy harvester at various output voltages	16

Figure 9 – Output power of a vibration based piezoelectric energy harvester at various external loads 17

Figure 10 – Output power and output voltage of a vibration based piezoelectric energy harvester at various input vibrations..... 17

Figure 11 – Transient response of output voltage of a vibration based piezoelectric energy harvester to excitation 18

Figure 12 – Block diagram of a test setup for evaluating the reliability of a vibration based piezoelectric energy harvester 19

Figure A.1 – Piezoelectric mode of vibrating beam based energy harvester21

Table 1 – Specification parameters for vibration based piezoelectric energy harvesters 11

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES – SEMICONDUCTOR DEVICES
FOR ENERGY HARVESTING AND GENERATION –

Part 1: Vibration based piezoelectric energy harvesting

FOREWORD

- 1) The International Electrotechnical Commission (IEC) is a worldwide organization for standardization comprising all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The object of IEC is to promote international co-operation on all questions concerning standardization in the electrical and electronic fields. To this end and in addition to other activities, IEC publishes International Standards, Technical Specifications, Technical Reports, Publicly Available Specifications (PAS) and Guides (hereafter referred to as “IEC Publication(s)”). Their preparation is entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested in the subject dealt with may participate in this preparatory work. International, governmental and non-governmental organizations liaising with the IEC also participate in this preparation. IEC collaborates closely with the International Organization for Standardization (ISO) in accordance with conditions determined by agreement between the two organizations.
- 2) The formal decisions or agreements of IEC on technical matters express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the relevant subjects since each technical committee has representation from all interested IEC National Committees.
- 3) IEC Publications have the form of recommendations for international use and are accepted by IEC National Committees in that sense. While all reasonable efforts are made to ensure that the technical content of IEC Publications is accurate, IEC cannot be held responsible for the way in which they are used or for any misinterpretation by any end user.
- 4) In order to promote international uniformity, IEC National Committees undertake to apply IEC Publications transparently to the maximum extent possible in their national and regional publications. Any divergence between any IEC Publication and the corresponding national or regional publication shall be clearly indicated in the latter.
- 5) IEC itself does not provide any attestation of conformity. Independent certification bodies provide conformity assessment services and, in some areas, access to IEC marks of conformity. IEC is not responsible for any services carried out by independent certification bodies.
- 6) All users should ensure that they have the latest edition of this publication.
- 7) No liability shall attach to IEC or its directors, employees, servants or agents including individual experts and members of its technical committees and IEC National Committees for any personal injury, property damage or other damage of any nature whatsoever, whether direct or indirect, or for costs (including legal fees) and expenses arising out of the publication, use of, or reliance upon, this IEC Publication or any other IEC Publications.
- 8) Attention is drawn to the Normative references cited in this publication. Use of the referenced publications is indispensable for the correct application of this publication.
- 9) Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this IEC Publication may be the subject of patent rights. IEC shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights.

International Standard IEC 62830-1 has been prepared by IEC technical committee 47: Semiconductor devices.

The text of this standard is based on the following documents:

FDIS	Report on voting
47/2341/FDIS	47/2366/RVD

Full information on the voting for the approval of this International Standard can be found in the report on voting indicated in the above table.

This document has been drafted in accordance with the ISO/IEC Directives, Part 2.

A list of all parts in the IEC 62830 series, published under the general title *Semiconductor devices – Semiconductor devices for energy harvesting and generation*, can be found on the IEC website.

The committee has decided that the contents of this document will remain unchanged until the stability date indicated on the IEC website under "<http://webstore.iec.ch>" in the data related to the specific document. At this date, the document will be

- reconfirmed,
- withdrawn,
- replaced by a revised edition, or
- amended.

IMPORTANT – The 'colour inside' logo on the cover page of this publication indicates that it contains colours which are considered to be useful for the correct understanding of its contents. Users should therefore print this document using a colour printer.

SEMICONDUCTOR DEVICES – SEMICONDUCTOR DEVICES FOR ENERGY HARVESTING AND GENERATION –

Part 1: Vibration based piezoelectric energy harvesting

1 Scope

This part of IEC 62830 defines terms, definitions, symbols, configurations, and test methods that can be used to evaluate and determine the performance characteristics of vibration based piezoelectric energy harvesting devices for practical use. This document is applicable to energy harvesting devices for consumer, general industries, military and aerospace applications without any limitations on device technology and size.

2 Normative references

The following documents are referred to in the text in such a way that some or all of their content constitutes requirements of this document. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.

IEC 60749-5:2003, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 5: Steady-state temperature humidity bias life test*

IEC 60749-12:2002, *Semiconductor devices – Mechanical and climatic test methods – Part 12: Vibration, variable frequency*

SOMMAIRE

AVANT-PROPOS	26
1 Domaine d'application	28
2 Références normatives	28
3 Termes et définitions	28
3.1 Termes généraux	28
3.2 Transducteur piézoélectrique	30
3.3 Paramètres caractéristiques	31
4 Valeurs assignées et paramètres caractéristiques essentiels	33
4.1 Identification et type	33
4.2 Valeurs limites et conditions de fonctionnement	33
4.3 Informations supplémentaires	34
5 Méthode d'essai	34
5.1 Généralités	34
5.2 Caractéristiques électriques	35
5.2.1 Procédure d'essai	35
5.2.2 Capacité	36
5.2.3 Fréquence de résonance	36
5.2.4 Largeur de bande	37
5.2.5 Tension en circuit ouvert	37
5.2.6 Tension de sortie	37
5.2.7 Courant de sortie	38
5.2.8 Puissance de sortie	38
5.2.9 Impédance de charge optimale	39
5.2.10 Puissance de sortie maximale	39
5.2.11 Durée d'établissement	39
5.3 Caractéristiques mécaniques	40
5.3.1 Procédure d'essai	40
5.3.2 Plage de températures	41
5.3.3 Plage d'humidité relative	41
5.3.4 Vibrations d'entrée	42
Annexe A (informative) Mode piézoélectrique	43
A.1 Mode d_{33}	43
A.2 Mode d_{31}	43
Bibliographie	44
Figure 1 – Dispositif de récupération d'énergie basée sur des vibrations utilisant la flexion d'un film piézoélectrique	29
Figure 2 – Schéma conceptuel d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations	30
Figure 3 – Circuit équivalent d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations	32
Figure 4 – Procédure de mesure du dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations	35
Figure 5 – Montage d'essai pour les caractéristiques électriques d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations	36
Figure 6 – Réponse fréquentielle d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations	37

Figure 7 – Tension de sortie d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations pour différentes charges externes	38
Figure 8 – Courant de sortie d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations pour différentes tensions de sorties	38
Figure 9 – Puissance de sortie d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations pour différentes charges externes	39
Figure 10 – Puissance de sortie et tension de sortie d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations pour différentes vibrations d'entrée	39
Figure 11 – Réponse transitoire de la tension de sortie d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations à une excitation.....	40
Figure 12 – Schéma de principe d'un montage d'essai pour évaluer la fiabilité d'un dispositif de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations	41
Figure A.1 – Mode piézoélectrique d'un dispositif de récupération d'énergie basé sur une poutre vibrante	43
Tableau 1 – Paramètres de spécification pour des dispositifs de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations	34

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS POUR RÉCUPÉRATION ET PRODUCTION D'ÉNERGIE –

Partie 1: Récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations

AVANT-PROPOS

- 1) La Commission Electrotechnique Internationale (IEC) est une organisation mondiale de normalisation composée de l'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de l'IEC). L'IEC a pour objet de favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de normalisation dans les domaines de l'électricité et de l'électronique. A cet effet, l'IEC – entre autres activités – publie des Normes internationales, des Spécifications techniques, des Rapports techniques, des Spécifications accessibles au public (PAS) et des Guides (ci-après dénommés "Publication(s) de l'IEC"). Leur élaboration est confiée à des comités d'études, aux travaux desquels tout Comité national intéressé par le sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'IEC, participent également aux travaux. L'IEC collabore étroitement avec l'Organisation Internationale de Normalisation (ISO), selon des conditions fixées par accord entre les deux organisations.
- 2) Les décisions ou accords officiels de l'IEC concernant les questions techniques représentent, dans la mesure du possible, un accord international sur les sujets étudiés, étant donné que les Comités nationaux de l'IEC intéressés sont représentés dans chaque comité d'études.
- 3) Les Publications de l'IEC se présentent sous la forme de recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux de l'IEC. Tous les efforts raisonnables sont entrepris afin que l'IEC s'assure de l'exactitude du contenu technique de ses publications; l'IEC ne peut pas être tenue responsable de l'éventuelle mauvaise utilisation ou interprétation qui en est faite par un quelconque utilisateur final.
- 4) Dans le but d'encourager l'uniformité internationale, les Comités nationaux de l'IEC s'engagent, dans toute la mesure possible, à appliquer de façon transparente les Publications de l'IEC dans leurs publications nationales et régionales. Toutes divergences entre toutes Publications de l'IEC et toutes publications nationales ou régionales correspondantes doivent être indiquées en termes clairs dans ces dernières.
- 5) L'IEC elle-même ne fournit aucune attestation de conformité. Des organismes de certification indépendants fournissent des services d'évaluation de conformité et, dans certains secteurs, accèdent aux marques de conformité de l'IEC. L'IEC n'est responsable d'aucun des services effectués par les organismes de certification indépendants.
- 6) Tous les utilisateurs doivent s'assurer qu'ils sont en possession de la dernière édition de cette publication.
- 7) Aucune responsabilité ne doit être imputée à l'IEC, à ses administrateurs, employés, auxiliaires ou mandataires, y compris ses experts particuliers et les membres de ses comités d'études et des Comités nationaux de l'IEC, pour tout préjudice causé en cas de dommages corporels et matériels, ou de tout autre dommage de quelque nature que ce soit, directe ou indirecte, ou pour supporter les coûts (y compris les frais de justice) et les dépenses découlant de la publication ou de l'utilisation de cette Publication de l'IEC ou de toute autre Publication de l'IEC, ou au crédit qui lui est accordé.
- 8) L'attention est attirée sur les références normatives citées dans cette publication. L'utilisation de publications référencées est obligatoire pour une application correcte de la présente publication.
- 9) L'attention est attirée sur le fait que certains des éléments de la présente Publication de l'IEC peuvent faire l'objet de droits de brevet. L'IEC ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de brevets et de ne pas avoir signalé leur existence.

La Norme internationale IEC 62830-1 a été établie par le comité d'études 47 de l'IEC: Dispositifs à semiconducteurs.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

FDIS	Rapport de vote
47/2341/FDIS	47/2366/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

Ce document a été rédigé selon les Directives ISO/IEC, Partie 2.

Une liste de toutes les parties de la série IEC 62830, publiées sous le titre général *Dispositifs à semiconducteurs – Dispositifs à semiconducteurs pour récupération et production d'énergie*, peut être consultée sur le site web de l'IEC.

Le comité a décidé que le contenu de ce document ne sera pas modifié avant la date de stabilité indiquée sur le site web de l'IEC sous "<http://webstore.iec.ch>" dans les données relatives au document recherché. A cette date, le document sera

- reconduit,
- supprimé,
- remplacé par une édition révisée, ou
- amendé.

IMPORTANT – Le logo "colour inside" qui se trouve sur la page de couverture de cette publication indique qu'elle contient des couleurs qui sont considérées comme utiles à une bonne compréhension de son contenu. Les utilisateurs devraient, par conséquent, imprimer cette publication en utilisant une imprimante couleur.

DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS – DISPOSITIFS À SEMICONDUCTEURS POUR RÉCUPÉRATION ET PRODUCTION D'ÉNERGIE –

Partie 1: Récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations

1 Domaine d'application

La présente partie de l'IEC 62830 définit des termes, des définitions, des symboles, des configurations et des méthodes d'essai qui peuvent être utilisés pour évaluer et déterminer les caractéristiques de performances de dispositifs pratiques de récupération d'énergie piézoélectrique basée sur des vibrations. Le présent document s'applique aux dispositifs de récupération d'énergie destinés à des applications grand public, industrielles, militaires et aérospatiales sans limitation sur la taille ni sur la technologie des dispositifs.

2 Références normatives

Les documents suivants cités dans le texte constituent, pour tout ou partie de leur contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

IEC 60749-5:2003, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 5: Essai continu de durée de vie sous température et humidité avec polarisation*

IEC 60749-12:2002, *Dispositifs à semiconducteurs – Méthodes d'essais mécaniques et climatiques – Partie 12: Vibrations, fréquences variables*